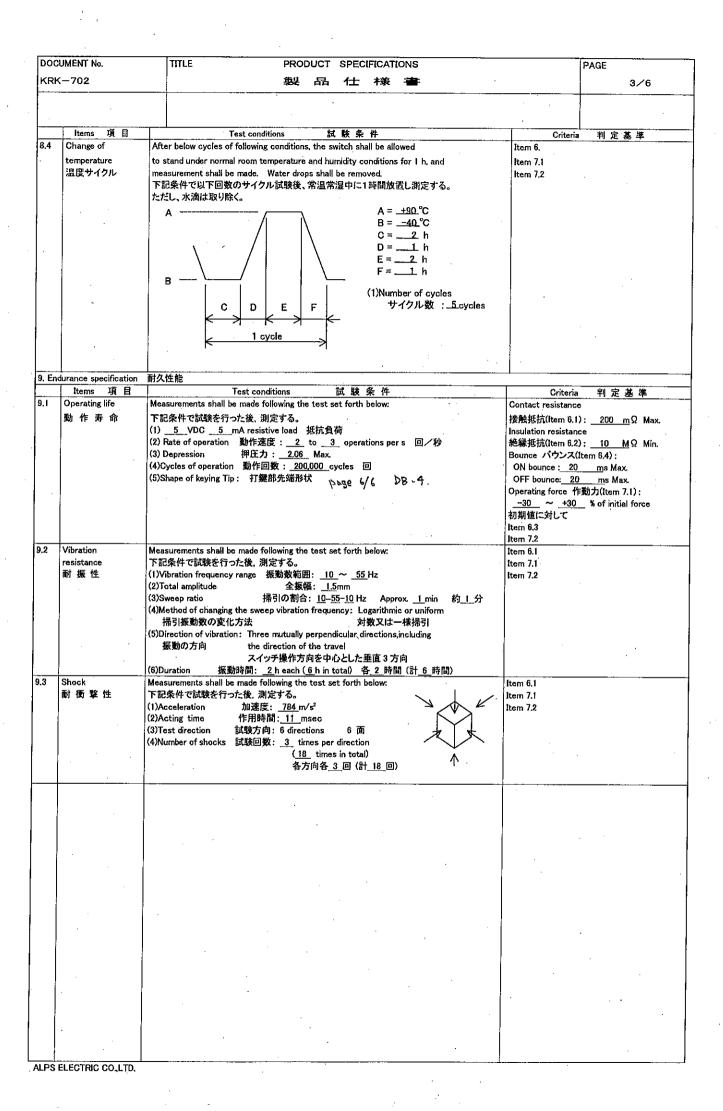
500	OLBATAIT AL.	TITLE PROPUST OPENING ATTOMS		
	CUMENT No.		· [PAGE
KR	K-702	製品仕様書		1/6
BAC	CKGROUND			
		· ·		
1. Ge	ieneral 一般事項	型型 記 仕 神寒 書 1/6 This specification is applied to TACT switches which have no keytop. 二の提供書は、キーカフなLの分外スケオニンとで、適用する。 正用温度範囲: 一名〇 ~ 90.7℃ (normal humidity, normal air pressure 常港 常任) 保存温度範囲: 一名〇 ~ 90.7℃ (normal humidity, normal air pressure 常港 常任) When the specification is specified the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. Ioliza 及び瀬淀は特に設定がない場別以下の様字状態の比とで持う。 Normal humidity 常 湿: (Relative humidity) 超度 25~85%) Normal humidity 常 湿: (Relative humidity) 超度 25~85%) Normal pressure 常 臣: (Air pressure 温度 5~35°C) Normal pressure 湿 臣: (Air pressure 気圧 86~1086年) If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions. ただし、判定活義者生じた情義者とした事情をは以下の基準技能で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2°C Relative humidity 相対譲渡: 60~7096 Air pressure 気 臣: 86~106kPa が親、形状・大き Tastall be no defects that affect the serviceability of the product 性能上有害な欠陥があってはならない。 Refer to the assembly drawings 製品図による。 Iactile feedback クティールフィード・グラク 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点 (Obtails of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による) 12 VDC 50m A 1 VDC 10 U A 能 Test conditions 試験条件		
	Application 適用範囲	This specification is applied to TACT switches which have no keytop.		
1.2	Operating temperature range	e 使用温度範囲: <u>−40</u> ~ <u>85</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿·常	is applied to TACT switches which have no keytop. +ーフなしの外入ケラにコンて 適用する。 -40~ 85°C (normal humidity, normal air pressure 常温・常臣) -40~ 85°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣) -40~ 81°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°C (normal humidity, normal air pressure 常温・宗臣 81°C) -40°C -40°	
1.3	Storage temperature range			
	Test conditions 試験状態			•
		試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。		
		Normal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35℃)		
		•		•
			ıs.	
			-	
		Air pressure 気 圧: 86~106kPa		· 1
^ Ac	this and dimensi	292 后 仕		
	ppearance, style and dimensi Appearance 小鏡			
۷.,	Appearance 71 au			•
2.2	Style and dimensions 形状			
 -	Style and uniformities.	、生産 (Telef to the assembly drawings. 支口はロローク・ショ		
3. Ty	ype of actuating 動作形式	Tactile feedback タクティールフィードバック	100	*
•.	po or accuming	I MANUEL TOO HOWAIT		
4. Ca	ontact arrangement 回路形	式 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点		
•			細は製品図による	3
			appet to many and a	
	atings 定格			
5.1	Maximum ratings 最大定格			
	Minimum ratings 最小定格		;	•
6. Ele	· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			な欠陥があってはならない。 nbly drawings. 製品図による。 タクティールフィードパック ws 1 回路 1 接点 arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による) m A u A cons 試験条件 Criteria 判定基準 conter of the stem, measurements shall be を加え、測定する。 : 3.14 N : I kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA 1kHz 微少電流接触抵抗計、又は DC5V 10mA 電圧降下法 wing the test set forth below: する。 100 V DC for 1 min. etween all terminals. And if there is a metal	
6.1	Contact resistance App			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1	Test conditions 試験条件 Criteria 判定基準 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be nade.		
	1			•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u>1·</u> _			
6,2	Insulation Mea			
	1			-
	Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		100M Ω Min.	
			100111	
6.3	Voltage proof Mea			
	1 .	here shall be no b	reakdown.	
	耐 電 圧 下記	各性で試験を行った後 測定する		
	1			
	(1)	Test voltage 印加電圧: 250 V AC (50~60Hz)		
	(1)	Test voltage 印加霍圧:250V AC (50~60Hz) Duration 印加時間:1 min		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
,	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加霞E:		
	(1)	Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) Duration 印加時間: 1 min Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	色縁破壊のないこと	-
	(1)	Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) Duration 印加時間: 1 min Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	e線破壊のないこと SGD. Apr.	[8.2006
	(1)	Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) Duration 印加時間: 1 min Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	e線破壊のないこと SGD. Apr.	[8.2006
	(1) (2) (3)	Test voltage 印加電圧:	e線破壊のないこと SGD. Apr.	18.2006 modera
	(1)	Test voltage 印加電圧:	を縁破壊のないこと SGD. Apr. J. C	18.2006 modera 02.2006
	(1) (2) (3)	Test voltage 印加電圧:	を縁破壊のないこと SGD. Apr. J. C	18.2006 modera
	(1) (2) (3)	Test voltage 印加電圧:	e線破壊のないこと SGD. Apr. J. C	18.2006 modera 02.2006
	(1) (2) (3)	Test voltage 印加電圧:	e線破壊のないこと SGD. Apr. J. C	18.2006 Modera 02.2006 SUZUKi

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE		
KRK-702		製品仕様書	2/6			
\vdash						
1	•	• '				
0.4	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteri			
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use	ON bounce : 10 ms Max.			
	バウンス	(3 to 4 operations per s),bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及び	OFF bounce: 10	OFF bounce: 10 ms Max.		
		OFF時のパウンスを測定する。		×		
	l .			•		
1			· ·			
		Switch				
		Uscilloscop Oscilloscop		. ,		
	,	<u>ー</u> 5V 5kΩ オシロスコープ				
		· \				
		<u> </u>				
		"ON"				
			İ			
	. 1					
1						
7 14-	hanical specification	機械的性能	1			
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	1 判定基準		
7.1		Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	1.57 ± 0.49 l			
	作動力	then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the				
İ		maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured.				
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を		•		
		加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。				
7.2	l	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	0.13 + 0.07/-	0.03 mm		
		then applying a below static load to the center of the stem the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.				
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重				
		を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。	İ			
		(1) Depression 押圧力: <u>3.14</u> N				
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is	0,29N Min.			
	1 1	vertical and upon depression of the stem in its center the travel distance, the				
		force of the stem to return tot its free position shall be measured.				
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、 操作部が復帰する力を測定する。	ļ			
7.4		Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	There shall be no	sign of damage		
77		then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.	Mechanically and			
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の	機械的、電気的に			
	!	静荷重を加える。				
		(1) Depression 押圧力: <u>29.4</u> N	•	·		
		(2) Time 時間: <u>15</u> s				
8. Env	ironmental specification	耐候性能		 -		
31 -117	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準		
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.			
ĺ		temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1			
	耐寒性	次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2			
		(1) Temperature 温 度: <u>−40</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時 間: <u>96</u> h				
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。				
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.			
	耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made;	Item 7.1			
	. :	次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2			
	,	(1) Temperature 温 度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃				
-		(2) Time 時間:96_ h	 			
		Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Contact resistance			
	The second secon	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Insulation resistant): <u>200</u> _mΩ Max.`		
		(1) Temperature 温度: 60_±2°C	1): <u>10</u> ΜΩ Min.		
	Ì	(2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6.3			
′		(3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 %	Item 6.4			
	ا	(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1 Item 7.2			
ļ			1.CIII 1.Z			
				İ		
		•				
		•				
ļ		ø				
ALPS	ELECTRIC CO.,LTD.					



DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE KRK-702 444 品 仕様 書 4/6 10. Soldering conditions 半田付条件 項目 Items Recommended conditions 推奨条件 10.1 Hand soldering Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 半田温度: <u>350</u>℃ Max. (1)Soldering temperature 連続半田時間:_ (2)Continuous soldering time 3 s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 60 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと 10.2 Reflow soldering Please practice according to below conditions. リプロー半田 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(℃) 260 °C Max. 3 s Max. Peak Temperature ピーク温度 230 180 150 Time 時間 40 s Max. 120s Max (Pre-heating 予熱) _3 ~ 4 min. Max. Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (2)Allowable soldering time 半田回数:_2_ time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。) 10.3 Other precautions (1) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 For soldering (Hand soldering) (2)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. 半田付けに関する スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 その他注意事項 (3) Hand soldering is suggested for this product to preclude flux penetration into electrical contacts, for dip soldering could pose this problem. (手半田用) 半田付けは手半田にてお願い致します。(オートディップ半田の場合、当製品はフラックスが接点内に浸入することがあります) 10,4 Other precautions (1)Switch terminals and PCB, Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 For soldering (Reflow soldering) (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付けに関する 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 その他注意事項 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent (リフロー用) 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面から フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。 (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right one before use, リフロー橋の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. **熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。** (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side, スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8)The thickness of cream solder: 0.15 mm クリーム半田印刷厚: 0.15 mm

DOCUMENT No.	TITLE PROD	OUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRK-702	製	品仕様書	5/6
1	•		i

【Precaution in use】 ご使用上の注意

A. General 一般項目

- A1. This switch has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, inform devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such As life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of suitability or check on us for the details. 本スイッチはオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。
- A2. This switch is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of Resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand. 本スイツチは直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L)、容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板实装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

 本スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので十分にご注意下さい。
- B3. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱腹歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- DI. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to Creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the Hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move. ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D4. Do not press recess on the stem zenith of the switch by sharp objects. スイッチのステム天面のくぼみ部分を鋭利なもので押すことは避けて下さい。
- D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けて下さい。
 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D6.Do not use the product in a manner that it is kept being powered. 常時電圧印加される様なご使用はお避け下さい
- D7. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stooner.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。(ストッパー強度参照)

- D8. This switch is designed to be used as reset switch. Recess is made on the stem zenith, whitch supports to guide the tip of operation part(i.e. pens) to the stem center portion. For applications other than reset switch, cares shall be taken to prevent the keytop from being located on such recess, conforming to the below specified conditions. 本スイッチはリセットスイッチとしての使用を目的とし、ステム天面へペン先等の操作部先端をステム中央へ誘導する為のくぼみを設けておりますが、リセットスイッチ以外の用途としてご使用の際は、キートップの配置はくぼみ部を避け以下の点にご注意の上設定下さい。
- D8-1.The inclination of the striking part shall be within 3 *. 打鍵部の傾斜は、3度以内に設定して下さい。
- D8-2. Allowable inclination of keying section: 90±3 degrees or less. 打鑢部中心軸線の傾きは、90±3度以内に設定して下さい。
- D8-3.Operating Conditions. 操作条件

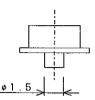
Deviation of striking part from the center axis of the switch shall be within 0.3mm. スイッチ外形を基準とする中心軸線よりの、打鍵部ズレは 0.3mm 以下にて御使用下さい。

DOCUMENT No.	TITLE	LE PRODUCT SPECIFICATIONS			PAGE	
KRK-702	* :	. 製品	仕 様		•	6/6
		,			,	,

D8-4.Shape of Keying Tip : 打鍵部先端形状

It is recommeded that the tip of the keying section be flat(ϕ 1.5).

φ1.5mmの円柱形状を推奨致します。



E. Using environment 使用環境

E1. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuratio and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supp

以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので使用環境に十分にご注意下さい。

- (1) Around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this product is always used in a place where exhaust gas from automobiles exist.
 - 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合
- (2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
 - 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。
 - ・When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.

 シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- (3) When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E2. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.

電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては,当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめ御了承下さい。

- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

